



All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

RPC-2.92 according to
RPC-2.92 mechanically compatible with
MINI-SMP according to

IEC 61169-35
RPC-3.50 and SMA
MIL-STD-348A, Fig. 328
Mateable with GPPO™ (Gilbert Engineering Co., Inc.)
and SSMP™ (Connectors Devices, Inc.)

Documents

N/A

Material and plating

Connector parts

Center contact
Outer contact RPC-2.92
Outer contact MINI-SMP
Dielectric 1
Dielectric 2

Material

Beryllium copper
Stainless steel
Beryllium copper
PS
PTFE

Plating

Gold, min. 1.27 µm, over chemical nickel
Passivated
Gold, min. 0.8 µm, over chemical nickel

**ADAPTOR
RPC-2.92 JACK – MINI-SMP JACK**

02K118-K00S3

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 40 GHz
Return loss	≥ 30 dB, DC to 12 GHz ≥ 26 dB, 12 GHz to 20 GHz ≥ 18 dB, 20 GHz to 40 GHz
Insertion loss	≤ 0.05 x √f(GHz) dB
Insulation resistance	≥ 5 GΩ
Center contact resistance RPC-2.92	≤ 3.0 mΩ
Outer contact resistance RPC-2.92	≤ 2.0 mΩ
Center contact resistance MINI-SMP	≤ 6.0 mΩ
Outer contact resistance MINI-SMP	≤ 2.0 mΩ
Test voltage	750 V rms
Working voltage	250 V rms

Mechanical data

Mating cycles RPC-2.92	≥ 500
Mating cycles MINI-SMP	
- if mating part is smooth bore	≥ 500
- if mating part is full detent	≥ 100
Center contact captivation	≥ 20 N
Coupling test torque RPC-2.92	1.70 Nm
Recommended torque RPC-2.92	0.80 Nm to 1.10 Nm
Engagement force MINI-SMP	
- if mating part is smooth bore	11 N max.
- if mating part is full detent	19 N max.
Disengagement force MINI-SMP	
- if mating part is smooth bore	11 N max.
- if mating part is full detent	29 N max.

Environmental data

Temperature range	-40°C to +85°C
Thermal shock	MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Corrosion	MIL-STD-202, Method 101, Condition B
Vibration	MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Shock	MIL-STD-202, Method 213, Condition I
Moisture resistance	MIL-STD-202, Method 106
RoHS	compliant

Tooling

N/A

Packing

Standard	1 pce in box
Weight	6.7 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Herbert Babinger	21/12/04	Martin Moder	08/07/14	c00	12-0205	Maik Knoll	08/07/14
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de					Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de		Page 2 / 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9